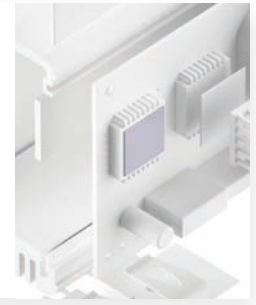


PHASE CHANGE COMPOUND TPC-Z-PC-HT-M/E HALA

druckbar

Thixotropischer Phase Change Compound zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kühlflächen. Der Compound benetzt beim Weichwerden oberhalb der Phase Change Temperatur und unter sehr geringem Druck die Oberflächenrauigkeiten sowie Unebenheiten und treibt die Luft-einschlüsse aus den Mikrostrukturen der Oberfläche aus. Die dünne Kontaktschichtdicke und die hohe Leitfähigkeit minimieren den thermischen Widerstand. Er kann mit Schablonendruck vorappliziert werden und ist nach Trocknung berührungstrocken und einbaubereit. Der Compound ist für Applikationen mit erhöhten Temperaturanforderungen entwickelt worden. TPC-Z-PC-HT-M und TPC-Z-PC-HT-E sind druckbare, alternativ lange und sehr lang trocknende Compounds. TPC-Z-PC-HT-E trocknet nur mit Zusatzwärme.



Stand 03 / 2020

EIGENSCHAFTEN

- Maximaler thermischer Kontakt durch dünne Kontaktschichtdicke
- Silikonfrei
- Wärmeleitfähigkeit: 3,0 W/mK
- Thixotropisch
- Ideale Alternative und Ersatz für Wärmeleitpaste
- Genau automatisierte Aufbringung durch Schablonendruck für die Massenproduktion
- TPC-Z-PC-HT-M mittlere Trockenzeit: @ RT oder Zusatzwärme
- TPC-Z-PC-HT-E lange Trockenzeit: Nur @ Zusatzwärme

LIEFERFORMEN

- TPC-Z-PC-HT-M und TPC-Z-PC-HT-E: Druckbare Typen
- mittlere -M und lange Trockenzeit -E
- E trocknet nur mit Zusatzwärme
- 360 ml SEMCO Kartuschen (transparent)
- 30 ml Kartuschen

ANWENDUNGSBEISPIELE

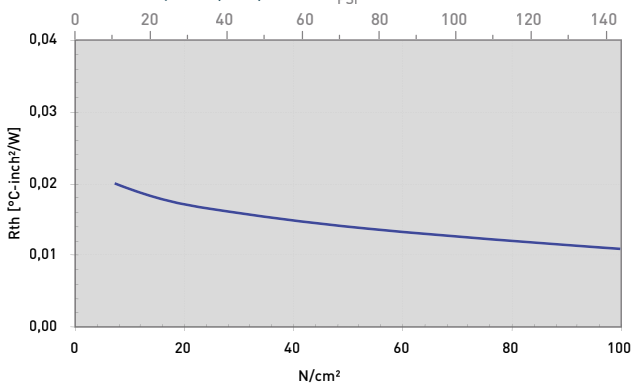
- Thermische Anbindung von z.B.
 - MOSFETs und IGBTs
 - Memorybausteinen
 - IGBT Leistungsmodulen
 - Prozessoren
- z.B. in Motorsteuerungen / Computern / Automationstechnik / Mikroelektronik

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TPC-Z-PC-HT-M	TPC-Z-PC-HT-E
MATERIAL			
MATERIAL		Trocknender Phase-Change Compound	
Farbe		Grau	Grau
Prozess		~ Druck	~ Druck
Dichte getrocknet	g/cm ³	2,3 @ RT	2,3 @ RT
ungetrocknet	g/cm ³	2,0 @ RT	2,1 @ RT
Viskosität getrocknet @ 10 rpm	Pas	45 @ 60°C / 30 @ 80°C / 21 @ 100°C / 15 @ 120°C	45 @ 60°C / 30 @ 80°C / 20 @ 100°C / 15 @ 120°C
ungetrocknet @ 10 rpm	Pas	60	77,5
Trocknung @ Temperatur @ Dicke	Zeit	@ 22°C: 24h (0,05 mm) 48h (0,15 mm) 56h (0,25 mm)	@ 60°C: 4h (0,05 mm) 12h (0,15 mm) 20h (0,25 mm)
		@ 60°C: 24 min (0,05 mm) 50 min (0,15 mm) 60 min (0,25 mm)	@ 125°C: 3 min (0,05 mm) 5 min (0,15 mm) 10 min (0,25 mm)
Lagerzeit (@ RT)	Monate	9	9
RoHS Konformität	2015/863/EU	Ja	Ja
THERMISCH			
Widerstand ¹ @ 1 MPa	°C-inch ² /W	0,011	0,011
Widerstand ¹ @ 200 kPa	°C-inch ² /W	0,017	0,017
Widerstand ¹ @ 70 kPa	°C-inch ² /W	0,020	0,020
Thermische Leitfähigkeit	W/mK	3,0	3,0
Phase Change Temperatur	°C	ca. 45	ca. 45
Betriebstemperaturbereich	°C	< 140	< 140
Max. Lagertemperatur	°C	25	25

Prüfmethode in Anlehnung an: ¹ ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.

R_{th} vs. N/cm² (PSI)



Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktkennung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreieren nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.